(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 10 月 8 日(08.10.2015)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2015/151514 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 23/02 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
H01L 23/06 (2006.01) *H03H 9/25* (2006.01)
H01L 23/29 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2015/001860

(22) 国際出願日: 2015 年 3 月 31 日(31.03.2015)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2014-073326 2014 年 3 月 31 日(31.03.2014) JP

(71) 出願人: ナガセケムテックス株式会社 (NAGASE CHEMTEX CORPORATION) [JP/JP]; 〒 5508668 大阪府大阪市西区新町１丁目１－１７ Osaka (JP).

(72) 発明者: 石橋　卓也 (ISHIBASHI, Takuya). 藤本　正稔 (FUJIMOTO, Masatoshi). 橋本　卓幸 (HASHIMOTO, Takayuki).

(74) 代理人: 河崎　眞一 (KAWASAKI, Shinichi); 〒 5410041 大阪府大阪市中央区北浜２丁目３番６号　北浜山本ビル Osaka (JP).

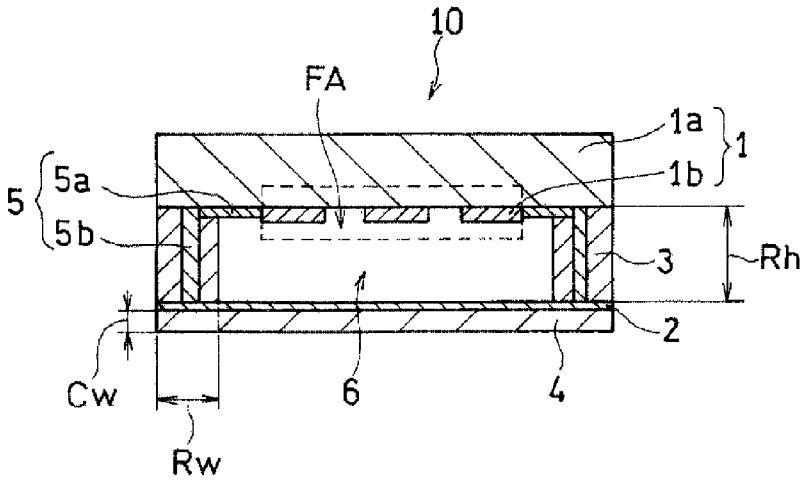
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) **Title**: CIRCUIT MEMBER HAVING HOLLOW SECTION, MOUNTING STRUCTURE, AND MOUNTING STRUCTURE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称 : 中空部を有する回路部材および実装構造体、ならびに実装構造体の製造方法



(57) **Abstract**: This circuit member is provided with: an element that is provided with a functional region; a flat-board-like cover section that is disposed to face the functional region; and ribs that are formed to surround the functional region for the purpose of forming a space between the functional region and the cover section. The cover section includes a sheet (S) having a thickness equal to or less than 100 μm, and a tensile elastic modulus (Es) of the sheet (S) at 175°C is equal to or higher than 10 GPa. It is preferable that the tensile elastic modulus (Es) of the sheet (S) at 175°C is equal to or higher than 20 GPa.

(57) 要約:　機能領域を備える素子と、前記機能領域に対向するように配置された平板状の蓋部と、前記機能領域と前記蓋部との間に空間を形成するために、前記機能領域を取り囲むように形成されたリブと、を備え、前記蓋部は、厚さが１００μｍ以下であるシートＳを含み、前記シートＳの１７５℃における引張り弾性率ＥｓがＧＰａ以上である、回路部材。前記シートＳの１７５℃における引張り弾性率Ｅｓは、２０ＧＰａ以上であることが好ましい。

WO 2015/151514 A1